

eDB-2000



eDB-2000 の特長

- 繰返し位置精度 $X \pm 20\mu\text{m}(3\sigma)$ 、 $Z \pm 10\mu\text{m}(3\sigma)$ 、 $\theta \pm 1^\circ(3\sigma)$
- コンパクトな装置サイズ W1500mm x D1040mm x H2000mm
- ボンディングヘッドとボンディングステージを 2 式搭載し、SUB MOUNT と LD CHIP を同時にボンディングします。
- ステムを固定した状態でボンディングステージが SUB MOUNT と LD CHIP のボンディング位置の間を水平移動することができます。
- ボンディングステージが移動することで、N2 雰囲気内でボンディングを完了でき、ワーク入れ替えによる位置ずれを防ぎます。
- SUB MOUNT と LD CHIP のボンディングを並行して行うため、ボンディング時間が短縮できます。
- Position accuracy $X \pm 20\mu\text{m}$ (3 σ), $Z \pm 10\mu\text{m}$ (3 σ), $\theta \pm 1^\circ$ (3 σ)
- Small footprint W 1500 mm x D 1040 mm x H 2000 mm
- Two bonding heads and two bonding stages are equipped, so bonding SUB MOUNT and LD CHIP at the same time is available.
- The bonding stage can be moved horizontally between the bonding position of SUB MOUNT and LD CHIP with the stem fixed.
- Bonding can be completed within the N2 atmosphere by moving the bonding stage, so this can be prevented position shift due to replacement of work.
- Speed-up, due to bonding of SUB MOUNT and LD CHIP can be performed in parallel.